

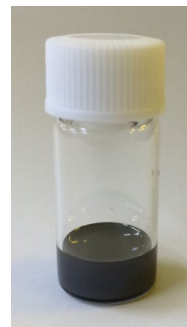
80°C焼成 低抵抗 Agナノインク 材料

Ag nano ink material for 3DPrinted electronics

材料設計 (Material design)

Agナノ粒子は40nm、130nmサイズであり、特殊分散安定材を使用した、80度焼成溶媒型銀ナノインクです。

Ag nano particle(40,130nm diameter) with special dispersant, solvent type Ag nano ink



特徴 (features)

	OAG-シリーズ
銀含有量 (Ag content)	20-85wt%
粘度 (Viscosity)	4-3000 mPa·s
貯蔵安定性 (storage stability)	>2 month@23°C
焼成条件 (sintering condition)	80°C/30 min-
体積抵抗値 (volume resistivity)	6 $\mu\Omega\cdot\text{cm}$ (80 °C) 4 $\mu\Omega\cdot\text{cm}$ (100 °C)
基材 (substrate)	PC,PET, PP, Si, Glass

・低濃度～高濃度まで可能

・室温での高い安定性

・低温焼成可能

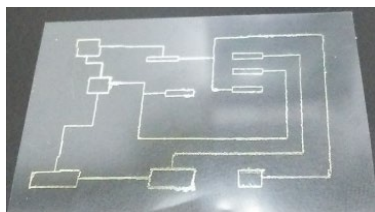
かつ低抵抗

・基材前処理必要なし

塗布プロセス (Coating Process)

2D構造体への塗布

-Inkjet



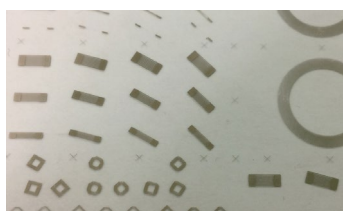
・Inkjet process
on PET film

-Aerosol jet



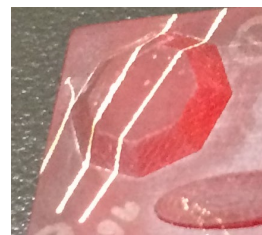
AJ-300 (Optomec)

-Gravure



・Smartlabo-III
(komura-tec)

3D構造体への塗布



・Inkjet process
on 3Dprint model